

5. EPC Conference in Köln

Höhere Ziele im Visier

Das EIPC European Institute of Printed Circuits lud zur 5. European Printed Circuit Conference nach Köln und viele kamen. Sahen vor zwei Jahren ein Großteil der Aussteller und der Besucher das baldige Ende dieser Veranstaltungsreihe kommen, waren die Meinungen im Oktober 2004 deutlich optimistischer – trotz sichtbar rückläufiger Besucher- und Ausstellerzahlen.



Bild 1: Laserbasierte Reparaturstation LaserScalpel von LPKF

Das im Zweijahres-Rhythmus veranstaltete Fachmeeting EPC Conference mit angeschlossener Produktschau hat sich nach Meinung der Veranstalter zu einem qualifizierten Branchenevent entwickelt. Auf diesem Weg sollen der Leiterplattenbranche im engeren und der Elektronik im weiteren Sinne Fachwissen und spezielle Erkenntnisse vermittelt werden, die in dieser Form nirgends erhältlich sind. Die Entscheidungsträger in relevanten betrieblichen Funktionen geben hier ihr Wissen in komprimierter Form an Wissensnachzügler weiter. Dabei hat man die Kollegen aus den USA vor Augen. Die veranstalten schon seit Jahr und Tag ihre Shows in wechselnden Folgen nach diesem Strickmuster und fahren recht gut damit.

Noch in den achtziger und neunziger Jahren waren diese Veranstaltungen beliebte

„Wallfahrtsorte“ für deutsche und europäische Unternehmer und Produzenten. Inzwischen haben sich auf Grund dramatischer Strukturwandlungen diese Schwerpunkte mit nachdrückgen Asien verschoben.

Einige brisante Themen aus den Seminarreihen in Köln waren „The Future of Legend Printing“ mit Adelino Sousa von MicroCraft, England, „Parallel Lamination Technique for High-density, High-Performance Printed Circuits Boards“ mit Tae-

Die Aussteller hingegen waren größtenteils zufrieden. Allen voran hatten DuPont, Hitachi, Lauffer, Mania Technologie AG und MIE recht große Standflächen für ihre Produktpräsentation belegt. Dort gab es zum Teil viele Neuheiten zu sehen, die in dieser Form zum ersten Mal das Licht der Fachöffentlichkeit erblickten.

Produktneuheiten in Kürze

Clariant, ehemals Hoechst, präsentierte einen neuentwickelten halogenfreien Flammhemmer für Basismaterialhersteller.

DuPont zeigte Trockenfilmlösungen für die unterschiedlichsten Aufgaben. Dazu zählten Fotowerkzeuge für die reibungslose und fachgerechte Verarbeitung.

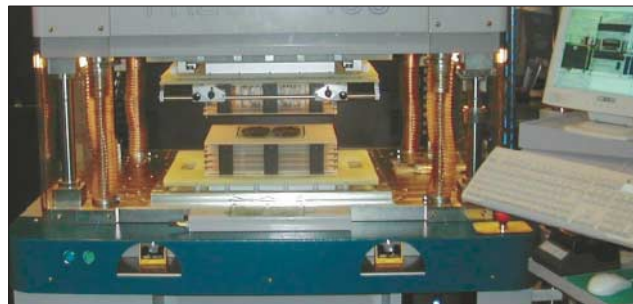


Bild 2: Parallel-Prüfgerät Quad-Density von Mania

Hitachi Europe GmbH stellte sich als Anbieter komplexer Bohrlösungen im Highend-Bereich vor. Daneben gab es Informationen über Laserbohren und mechanisches Bohren einschließlich Bohrlochinspektionen.

LPKF war mit einer neuen laserbasierten

Reparaturstation LaserScalpel (Bild 1) dabei. Per Optik wird dem Fehler näher gerückt, um ihn dann wirtschaftlich zu beheben.

Die Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. stellte eine verbesserte Multilayer-Pressen vor. Nicht im Original sondern per Poster, das über dem Stand schwebte, wurde das Kurztakt-Laminiersystem SL 80-2 für die Leiterplattenindustrie gezeigt. Die Mania Technologie AG präsentierte mit dem neuen Einspindel-Bohrautomat Micronic 81, eine Maschine mit hohem Spezifikationsstandard. Damit ►

Reparaturstation LaserScalpel (Bild 1) dabei. Per Optik wird dem Fehler näher gerückt, um ihn dann wirtschaftlich zu beheben.

Die Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. stellte eine verbesserte Multilayer-Pressen vor. Nicht im Original sondern per Poster, das über dem Stand schwebte, wurde das Kurztakt-Laminiersystem SL 80-2 für die Leiterplattenindustrie gezeigt.

Die Mania Technologie AG präsentierte mit dem neuen Einspindel-Bohrautomat Micronic 81, eine Maschine mit hohem Spezifikationsstandard. Damit ►

AUTOR

Manfred Frank
Freier Mitarbeiter *productronic*



Bild 4: Michael Weinhold, Technical Director des EIPC European Institute of Printed Circuits

Manfred Frank im Gespräch mit Michael Weinhold (Bild 4), Technical Director des EIPC European Institute of Printed Circuits über die Ziele des EIPC und die EPC Conference.

Seit wann gibt es das EIPC?

Gegründet wurde das EIPC vor 30 Jahren als Schweizer Leiterplatten Association, um die europäische Leiterplattenindustrie nach außen hin zu vertreten. Als Mitglied im WECC World Electronic Circuits Council treten wir als europäischer Partner in dieser Vereinigung auf. Ziel sind gemeinsame Veranstaltungen und, was noch wichtiger ist, uns auf gemeinsame Standards zu verständigen. Wir arbeiten auch sehr eng mit IPC, International Institute of Printed Circuit, in den USA zusammen, um gemeinsam zu vernünftigen Standards zukommen. Wir selbst erstellen keine Standards sondern arbeiten intensiv in diesen Arbeitsgruppen mit. Zugleich bringen wir über die schweizerische elektrotechnische Kommission IETC, International Electric Technical Commission die Standards, die auf IPC-Standards basieren, in die Leiterplattenindustrie. Seit den letzten 15 Jahren arbeiten zudem an einer Harmonisierung dieser Normen.

Welche Verbindungen bestehen in diesem Zusammenhang mit dem FED?

Der FED, Fachverband Elektronikdesign, ist eine Nachfolgeorganisation der ursprünglich in den achtziger Jahren gegründeten International Circuit Design Association, die weltweit agierte. Der FED übernahm den deutschsprachigen Raum, während der IPC mit dem Designer Council den englischsprachigen Raum übernahm. Die vertreten im wesentlichen die Designer.

In solchen Organisationen gilt in erster Linie die Lösung von Problemen im Sinne der Leiterplattenindustrie als oberstes Ziel. Alle anderen Ziele haben sich unterzuordnen. Mit Blick auf die Internationalität ist das von immenser Wichtigkeit. Auch der VdL spielt da hinein. Wir versuchen auch hier auf nationaler und internationaler Ebene die Zusammenarbeit. Doch mitunter ist nicht so einfach wie sich das anhört. Das liegt vielleicht mit daran, dass die ehemaligen Urgesteine der heutigen Leiterplattenindustrie Gründungsmitglieder der Productronica und der electronica waren. Eine so spezielle Ausstellung wie wir sie hier in Köln haben, würde von dieser Seite kaum Unterstützung finden. Aber zum anderen fließen die Einkünfte, die wir hier erzielen, wieder in die Industrie zurück in Form von Trainings. Dagegen geben die großen Messegesellschaften mit ihrem großen Verwaltungsaufwand nichts oder wenig an die Industrie zurück.

Welche Ziele verfolgt der EIPC weiterhin?

Wir müssen die Kommunikation zu den anderen Ländern pflegen und ausbauen. Wir brauchen eine Partnerschaft auf breiter Front. Sehen wir uns die EPC-Schau hier an. Die wird heute von englischsprachigen Firmen dominiert, die ausstellen und mit einer Reihe von Fachvorträgen das Programm mitgestalten. Während sich die deutsche Industrie davon fast abgesondert hat. Wir bedauern das. Wenn wir als Veranstalter einen UL-Workshop veranstalten, um den Leuten zu zeigen wie sie am schnellsten eine UL-Qua-

lifizierung für neue Produkte bekommen, und ganze zwei Teilnehmer kamen, dann können wir nur mit dem Kopf schütteln. Denn jeder Hersteller in Europa ist

mit dem Problem in den nächsten Jahren konfrontiert. Halofreiheit und Hoch-TG-Materialien spielen dabei eine große Rolle. Schade. Auch beim Thema der eingebetteten passiven Bauelemente lief es ähnlich.

Waren nicht zu Beginn ihrer Veranstaltungsreihen mehr deutsche Aussteller zu verzeichnen als heute? Hat sich denn die Struktur der Besucher verschoben?

Das würde ich so nicht unterstreichen. Wir hatten schon immer Wert gelegt auf Internationalität. Wir hatten schon immer englischsprachige Klientel und Leute aus anderen europäischen Ländern. Asiaten, früher über Distributoren vertreten, sind hinzugekommen. Von der Seite her muss ich sagen, das Profil hat sich nicht wesentlich geändert. Aber es richtig was Sie sagen, die deutsche Industrie, insbesondere die großen darunter, wollen keine Messe jedes Jahr. Alle zwei Jahre Productronica reichen aus. Alle anderen Länder dagegen haben jedes Jahr eine Veranstaltung. Und das ist mit Blick auf die schnellen Technikwechsel auch durchaus angebracht.

Welche konkreten Zielsetzungen verfolgen Sie in den kommenden Jahren mit der Kombination Workshops und Ausstellung?

Für die Leiterplatten- und Zulieferindustrie und auch mit Abstrichen für den Bestückbereich muss man schauen, dass man eine Messe mit Fokus schafft,

die überschaubar ist und von der der Besucher in von ein oder zwei Tagen einen erschöpfenden Informationsgehalt bekommt. Bei den Großveranstaltungen ist im Endeffekt so viel Beiwerk, dass die Kerninformationen mühsam erarbeitet werden müssen. Wir favorisieren Veranstaltungen mit Ausstellung und Tutorials, um den Fokus Electronics made in Europe entsprechend zu transportieren. Dazu wird es sicher wichtig sein, auch die wichtigen OEMs und andere zukünftig mit ins Boot zu holen. Wichtig ist, den Leuten aktuelles Fachwissen zu vermitteln und das Equipment dazu und den Kontakt zu den Kollegen.

Sie sehen also für die Zukunft noch genügend Aufgaben für den EIPC?

Ich persönlich sehe eine Menge an Aufgaben vor uns. Einmal den Kontakt zur Außenwelt, ob das nun USA oder Asien ist, weiter auszubauen. Da sind wir ohnehin schon sehr gut. Besser als irgendeine Association in Europa. Und wir können uns hier bei den Veranstaltungen vergleichen mit der IPC in USA. Um im Innenverhältnis in Europa ein einheitliches Europa auf dem Sektor Leiterplatten zu schaffen, da müssen noch erhebliche Kräfte investiert werden, um das zu realisieren. Das ist kein Thema, das sich von heute auf morgen erledigen lässt. Wir von unserer Seite sind für Kooperationen und Gespräche mit allen Seiten offen. Wichtig ist, dass wir unseren Zielen näher kommen.


 **EIPC** Kennziffer 419
 European Institute of Printed Circuits
 Fax +31/31/3 44 08 73
 www.eipc.org



Bild 3: Platinendrucker auf Inkjet-Basis CP 400 von EIE

stößt man in Bohrgeschwindigkeiten bis 250 000 U/min vor. Kameragesteuerte Ausrichtung, Werkzeugmanagement mit und ohne Ringen in den Euro-Werkzeugmagazinen und Laserwerkzeugvermessung gehören zur üblichen Ausstattung. Der SilverWriter 8000 schafft jetzt mehrere

Kassetten und größere Formate. Mit dem Parallel-Püfgerät Quad-Density (Bild 2) wurde eine Neuerung für den Test hochkomplexer Netze vorgestellt. Der Argos 8008 war ebenso zu finden wie das Softwarepaket Jobfinder, das Kosten beim Handling mit CAD- und CAM-Daten einspart.

Unter dem Dach der Multiline International Europa L. P., MIE, hatten sich alle Unternehmen aus dem Vertriebsprogramm aufgestellt. EIE zeigte neben seinen Präzisionsplottern mit dem CP 400 (Bild 3) einen Platinendrucker auf Inkjet-Basis, den MicroCraft in anderer Bauform auch vorstellte. ECI Technology Inc., ESI Electro Scientific Industries Ltd., HATS Highly Accelerated Thermal Shock tesor, Ishii Hyoki Co. Ltd., Lightning Technologies International und SDI stellten sich den Fragen der Besucher.

Rundum zufrieden war man bei CeramTec. Dort wurde für den Werkstoff Keramik als Leiterplattenmaterial reges Interesse notiert. CeramTec sieht in den Veranstaltungen wie z. B. in Köln die Chance, der Kera-

mik zu einer größeren Bekanntheit auch im Elektronikfertigungs-Bereich zu verhelfen. Die italienische Seica stellte ein breite Palette an Testlösungen vor: Flying-Probe-Tester in verschiedenen Variationen, In-Circuit- und Funktionstester mit parallelem Visualisierungssystem sowie Inline-Flying-Probe-Testsysteme inklusive Reparaturplatz.

Hakuto mit seinen Belichtungs- und Laminier-Systemen wurde von der SAT Electronic GmbH vertreten. Im Blickpunkt der Besucher stand ein Abziehautomat für Mylarfolien.

ÜBER DEN EIPC

Das European Institute of Printed Circuits wurde 1968 als schweizerische Leiterplatten-Association gegründet, mit dem Ziel einer Interessenvertretung der Mitglieder europa- und weltweit. Auf dem Aktions-Portfolio stehen die Einflussnahme auf Normungen und Qualifikationen, die Förderung der Weiterbildung, die intensive Zusammenarbeit mit allen relevanten Verbänden und Institutionen zur Erhaltung und Wahrung technischer und fertigungstechnischer Kompetenzen.

Im Januar 2004 zählte das EIPC 200 Mitglieder aus den Bereichen Basismaterialhersteller, Geräte- und Anlagenhersteller, Leiterplattenproduzenten, Zulieferer, EMS und Elektronik-Dienstleister. Chairman ist zur Zeit Paul Waldner, Managing Director of MIE Multiline International Europe L.P., Deutschland. Als Vice Chairmen agieren Martin Goosey, Shipley Europe Ltd., England und Giovanni Tridenti, SO.MA.CIS, Italien, als

Schatzmeister Michael Weinhold, DuPont, Schweiz und als Vorstand Rex Rosario, Graphic PLC, England, Ennio Panza, Euro Cipel S.A., Schweiz, Jules Limpens, Cimnet Systems, Deutschland, Joachim Zimmermann, Bosch, Deutschland, Steve Thomas, Technic Electric Ltd., England, Arie Reichert, Eltek, Israel, Russ Crockett, DuPont, Hannu Pääärni, Aspocomp, Finnland, Brewster Barclay, Belgien und Steve Jones, England.

Der EIPC pflegt intensiven Erfahrungsaustausch und enge Kooperation innerhalb des WECC World Electronic Circuit Council mit den weiteren Mitgliedern wie der China Printed Circuit Association (www.cpc.a.org.cn), der Hong Kong Printed Circuit Association (www.hkpc.a.org), der IPC Association Connecting Electronics Industries (www.ipc.org), der Japan Printed Circuit Association (www.jpca.org.jp) der Korea Printed Circuit Association (www.kpc.a.org.kr) und der Taiwan Printed Circuit Association (www.tpca.org.tw).

KONTAKT	
CeramTec	Kennziffer 421 Fax +49/92 31/6 24 09 www.ceramtec.de
Clariant Pigments & Additives	Kennziffer 422 Fax +49/61 96/7 57 81 09 www.pa.clariant.com
DuPont	Kennziffer 423 Fax +41/22/7 17 56 61 www.dupont.com/pcm
Hakuto / SAT Elektronik	Kennziffer 424 Fax +49/80 62/72 98 29 www.satgmbh.org www.hakuto.co.jp
Hitachi Europe	Kennziffer 425 Fax +49/2 11/5 28 36 19 www.hitachi-eu.com
LPKF Laser & Electronics	Kennziffer 426 Fax +49/51 31/70 95 90 www.lpkf.de
Maschinenfabrik Lauffer	Kennziffer 427 Fax +49/74 51/90 21 09 www.lauffer.de
Mania Technologie	Kennziffer 428 Fax +49/60 83/28 01 52 www.maniagroup.com
Multiline International Europa	Kennziffer 429 Fax +49/61 72/76 07 50 www.mie.de
Seica S. p. A.	Kennziffer 430 Fax +39/1 25/63 68 99 www.seica.com